



한국IR협의회

기업리서치센터 기업분석 | 2026.01.22



코스닥글로벌상장법인

코스닥글로벌세그먼트

KOSDAQ | 반도체와반도체장비

피에스케이 (319660)

PR Strip 중심 성장 지속

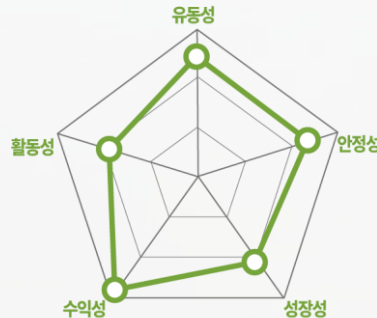
체크포인트

- AI 수요 강세 지속으로 HBM향 DRAM 및 선단 Logic 반도체 CAPA 확대가 전망. 이에 따라 동사 PR Strip 장비 수요 강세가 2026년에도 지속될 것으로 예상
- 중국 반도체 국산화로 동사 2025년 중국향 매출액도 전년 대비 약 50% 감소. 과거 하락폭이 컸던 만큼, 2026년 추가적인 하락 제한적일 것으로 예상. 다만 이로 인해 신규 장비인 Bevel Etcher의 성장이 다소 지연. 신규 Dry Cleaning 장비로 지속적으로 장비 다변화 시도할 계획
- 2026F 매출액 5,068억 원(+15.0% YoY), 영업이익 1,087억 원(+16.6% YoY)을 전망. 고객사 투자 증가에 기인. 미중 갈등 지속으로 향후 미국에 투자되는 Fab은 중국 장비 배제 움직임으로 동사의 반사 수혜를 기대

주가 및 주요이벤트

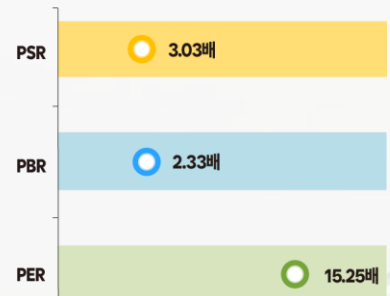


재무지표



주: 2024년 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PBR은 2024년 기준, PBR은 3Q25 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가

피에스케이 (319660)

Analyst 박성순 sspark@kirs.or.kr

RA 김혜빈 hbkim@kirs.or.kr

KOSDAQ

반도체와반도체장비

글로벌 1위 PR Strip 공급 업체

피에스케이는 1990년 설립되어 2019년 피에스케이홀딩스로부터 인적 분할하여 설립된 반도체 장비 업체. 주요 장비는 PR Dry Strip으로 동사가 글로벌 1위 기업이며, 전사 매출액의 약 70~80%를 차지. 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, Micron, Intel 등이 있음

2026년 DRAM 및 Logic 선단 공정 투자 확대

메모리 업사이클에서 대형주와 전공정 장비주의 주가는 동행성을 보임. CAPEX는 장비업체의 매출로 인식이 되며 실적 개선으로 이어짐. 주가가 실적과 밸류에이션의 함수라는 측면에서 실적 개선은 주가 상승을 유발. 2026년 삼성전자의 P4, SK하이닉스의 M15x, Micron의 전환투자와 함께 비메모리는 삼성전자의 Taylor Fab, Intel의 Arizona Fab52 투자가 예상. 2025년 T.I를 신규 고객사로 확보하였듯 향후 북미 시장에서 점유율 확대 기대. 현주가는 2026F PER 12.0x로 역사적 고점(16.5x)에 아직 미치지 못함

고객사 CAPA 투자로 PR Strip 중심 실적 증가 전망

2026F 매출액 5,068억 원(+15.0% YoY), 영업이익 1,087억 원(+16.6% YoY)을 전망. AI 수요 강세가 지속되며 반도체 고객사의 DRAM 및 비메모리 선단 공정 중심 투자로 PR Strip 장비 중심의 성장이 지속될 것으로 예상. 향후 미국에 투자되는 Fab은 중국 장비 배제 움직임으로 동사의 반사 수혜를 기대. 중국향 매출은 이미 충분히 감소한 수준으로 추가적인 하락 가능성도 제한적일 것으로 판단. 투자 속도에 따라 하반기 동사의 추가적인 실적 업사이드 가능성도 있음

Forecast earnings & Valuation

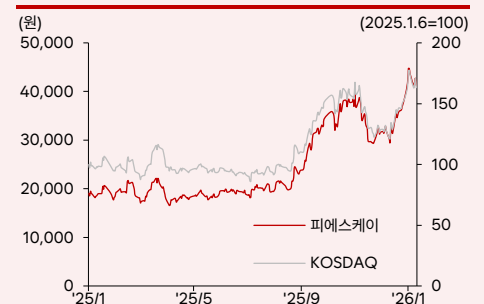
	2022	2023	2024	2025F	2026F
매출액(억원)	4,609	3,519	3,981	4,408	5,068
YoY(%)	3.4	-23.7	13.1	10.7	15.0
영업이익(억원)	918	541	839	933	1,087
OP 마진(%)	19.9	15.4	21.1	21.2	21.5
지배주주순이익(억원)	774	525	791	831	966
EPS(원)	2,647	1,813	2,732	2,869	3,336
YoY(%)	1.9	-31.5	50.7	5.0	16.3
PER(배)	5.8	11.6	6.0	12.9	12.0
PSR(배)	1.0	1.7	1.2	2.4	2.3
EV/EBITDA(배)	2.6	7.2	2.9	7.9	7.2
PBR(배)	1.3	1.6	1.0	2.0	1.8
ROE(%)	24.1	14.1	18.3	16.4	16.5
배당수익률(%)	2.6	1.0	2.4	1.1	1.0

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (1/20)	40,050원
52주 최고가	44,700원
52주 최저가	16,570원
KOSDAQ (1/20)	976.37p
자본금	146억원
시가총액	11,601억원
액면가	500원
발행주식수	29백만주
일평균 거래량 (60일)	38만주
일평균 거래액 (60일)	139억원
외국인지분율	25.97%
주요주주	피에스케이홀딩스 외 12 인 32.86%
	국민연금공단 7.08%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	275	98.3	110.8
상대주가	196	66.6	57.1

▶참고 1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 EPS 증가율, 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '총자산회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

▶'글로벌 세그먼트'는 코스닥 시장 내 재무실적과 시장평가, 기업지배구조가 우수한 기업으로 한국거래소에서 선정된 기업



기업 개요

1 피에스케이는 반도체 전공정 세정 및 식각 장비 전문 기업

1990년 설립되어

2019년 피에스케이홀딩스로부터

인적 분할하여 설립된

글로벌 1위 PR Strip 장비 업체

피에스케이는 1990년 설립된 반도체 전공정 장비 전문기업이다. 1994년 200mm Dry Strip 장비를 개발하며 반도체 장비 시장에 진입했고, 1999년 300mm 장비로 제품 라인을 확대했다. 2001년에는 세계 최초로 300mm Asher 양산 라인에 장비를 납품하며 기술 경쟁력을 입증했다. 이후 2007년 Dry Strip 장비 글로벌 시장점유율 24%를 기록했으며, 2010년에는 점유율이 34%까지 확대되는 등 시장 내 입지를 강화해왔다. PR Dry Strip 장비는 반도체 회로 패턴 형성 과정에서 사용된 감광액(Photoresist, PR)을 제거하는 장비로, 동사 매출의 약 70~80%를 차지하고 있다.

해외 거점도 단계적으로 확장했다. 2003년 대만 현지법인을 설립, 2004년 싱가포르 지점 개설, 이후 2017년 중국 상하이 법인을 추가로 설립하며 중국 시장 대응 기반을 마련했으며, 같은 해 Intel과 SK하이닉스로부터 우수 공급사/협력사로 선정되며 글로벌 고객 신뢰도를 높였다. 제품 포트폴리오 측면에서는 2014년 차세대 Dry Cleaning System과 Non-O₂ Strip System을 개발하며 공정 변화에 대응하는 라인업을 보강했다. 이어 2018년에는 전략적 사업구조 재편을 단행해 피에스케이홀딩스를 설립하며 첨단 패키징 장비 시장에 진출했고, 2019년 인적분할을 통해 피에스케이(주)를 신설해 코스닥에 재상장했다. 이를 통해 전공정 장비 중심의 사업 집중도를 높이면서도 독자적 성장 체계를 구축했다.

최근에는 기술 혁신과 투명경영을 기반으로 대외 신뢰를 강화하는 흐름이 이어졌다. 2021년 코스닥대상 최우수투명경영상을 수상하고 2022년 소부장 으뜸기업으로 지정되는 등 기술역량과 정보 투명성을 함께 인정받았다. 또한, 2022년 코스닥 글로벌세그먼트 편입을 통해 글로벌 기업으로서의 위상도 강화했다. 2023년에는 글로벌 IP 스타기업으로 지정되었으며, 2024년 판교캠퍼스 개관으로 R&D 인프라를 확충해 차세대 기술 개발 기반을 강화하는 등 첨단 공정 대응 장비 고도화와 시장 확대를 통해 전방 산업의 기술 진화에 맞춘 성장을 이어가고 있다.

피에스케이 주요 연혁

1990~1993 설립	1994~2001 시장진입	2002~2007 고성장 도약	2008~2012 제품 다각화	2013~2016 재도약	2017~현재 성장 발전
1990.06 회사 설립	1994.06 부설연구소 설립 200mm dry strip 개발 1997.01 코스닥 상장 1997.02 200mm dry strip (single type) 국산화 1999.03 300mm dry strip 개발 2000.05 미국 현지법인 설립 2001 세계최초 300mm asher 양산라인 납품 (삼성전자)	2003.04 대만 현지법인 설립 2004.04 싱가포르 현지 지점 설립 2005.05 Outstanding Contribution Award(SK하이닉스) 2005.11 협성회 사회봉사단 조직 (반도체/LCD 회원사 중심) 2006.04 300mm Lite Etching System (TSL3000) 2006.06 세계일류상품 (산업자원부) 2006.11 기술협력우수상 (삼성전자) 2007.02 Best Partner Award 금상 (삼성전자) 2007.04 Dry strip 세계 시장점유율 1위 (24%, Gartner) 2007.05 Technology Fast 50 우수상 (Deloitte) 2007.07 300mm Plasma Oxide Cleaning System (ZIVIS) Award of Appreciation (하이닉스-ST) 2007.10 Certificate of Registration, Information 4 Security Management System, BSI 2007.11 삼성전자 협력회사 혁신 우수상 (기술혁신 부문) 2007.11 5년만물 수출의탑, 철합산업훈장 수상 2007.11 300mm Advanced Dry Strip System (SUPRA V)	2008.12 우수제조기술연구센터 지정 (지식경제부) 2009.06 300mm H2 Ashing System (FUTAS) 2009.07 노사상생 양보교섭 실천기업 (노동부) 2009.11 협력회사 혁신우수상 (삼성전자) 2010.03 Dry strip 세계 시장점유율 1위 (34%, Gartner) 2011.11 한국히트컴퍼니 육성사업 인증 (한국수출입은행) 2012.03 프로세스 혁신 동상 (삼성전자) 2012.03 대표이사 협성회 수석부회장 선임 2012.05 World Class 300 육성대상기업 지정 2012.05 전력반도체 장비 일본 수출 (dry strip와 etcher) 2012.05 TVS 장비 개발 (성광공업제): Ecolite I (300), II (400) 2012.12 미국 SEMI gear 인수 (마케팅 장비 및 reflow) 2012.12 KB Hidden Star 500 지정 2012.12 PoP 장비 공동개발 (삼성전자): Ecolite LT	2013.07 G450C에 450mm dry strip 납품 2013.08 차세대 hardmask strip 장비 개발 2013.08 중국 시안 현지법인 설립 2014.02 Appreciation Award (SEMI) 2014.08 차세대 dry cleaning system 개발 (INTEGRER plus) 2014.10 Non-O2 dry strip system 개발 2015.03 혁신우수협력사 은상 (삼성전자) 2015.04 Non-O2 Dry Strip System (ZEDIUS) 2015.05 FOMLP surface treatment solution 개발 협력 2015.10 은탑 산업 훈장 (대통령) 2016.07 직무발명보상우수기업 지정 2016.08 우수제조기술연구센터 우수과제 선정 2016.12 공로 기념패 (KOTRA)	2017.03 혁신우수협력사 정려상 (삼성전자) 2017.03 중국 상하이 현지법인 설립 2017.08 Smart Factory 구축 2017.08 소재 부품 전문기업 2017.10 우수공급자 표창 (Intel) 2017.11 우수협력사 동반성장 (SK하이닉스) 2017.12 석탑산업훈장 (대통령) 2017.12 철관반물 수출의탑 2018.01 청년 친화 강소기업 선정 2018.04 혁신우수협력사 (삼성전자) 2018.09 회사 분할 결정 (인적분할) 2018.12 경기도축전회 알하기 좋은 기업 2019.04 피에스케이(주) 설립 (피에스케이홀딩스(주)로부터 인적분할 신설) 2019.05 코스닥시장 재상장 2019.05 기업부설연구소 설립 2020.04 소재부품장비 전문기업 2020.08 성능개선평가 인증 2020.10 소재부품장비 핵심전략기술 2020.12 일본 현지법인 설립 2020.12 금탑 산업 훈장 (행정안전부) 2021.12 코스닥대상 최우수투명경영상 2022.01 소부장 으뜸기업 지정 2022.11 코스닥 글로벌세그먼트 편입 2023.04 글로벌 P-스타기업 지정 2023.05 고용노동부 강소기업 선정 2023.11 세계일류상품 (Dry Cleaning) 인증 2024.05 판교캠퍼스 개관 2024.10 금탑 산업 훈장 (행정안전부)

자료: 피에스케이, 한국IR협의회 기업리서치센터

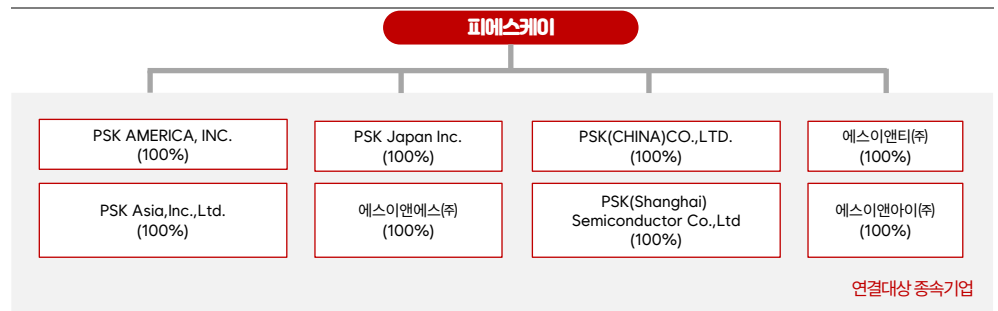
 종속회사 현황

3Q25말 기준 연결대상

종속기업은 비상장 8개사

피에스케이는 연결대상 종속회사로 8개의 비상장사를 보유하고 있다. 1) PSK AMERICA, INC.(지분율 100.0%, 3Q25 말 기준 자산총액 229억 원)는 미국, 아일랜드 현지 고객사에 대한 반도체장비 분야 부품 판매 및 기술 서비스를 제공하고 있다. 2) PSK Asia, Inc., Ltd.(지분율 100.0%, 3Q25말 기준 자산총액 296억 원), 3) PSK(CHINA)CO.,LTD.(지분율 100.0%, 3Q25말 기준 자산총액 155억 원), 4) PSK(Shanghai) Semiconductor Co.,Ltd(지분율 100.0%, 3Q25말 기준 자산총액 363억 원), 5) PSK Japan Inc.(지분율 100.0%, 3Q25말 기준 자산총액 84억 원) 4개사는 각각 미국, 중국, 일본 고객사에 대한 반도체 장비 판매를 담당하고 있다. 6) 에스이앤에스(주)(지분율 100.0%, 3Q25말 기준 자산총액 17억 원), 7) 에스이앤티(주)(지분율 100.0%, 3Q25말 기준 자산총액 16억 원), 8) 에스이앤아이(주)(지분율 100.0%, 3Q25말 기준 자산총액 10억 원)은 국내 장비 엔지니어링 서비스 및 제조사업을 영위하고 있다.

피에스케이 지분도



주: 3Q25말 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

피에스케이 연결대상 종속회사 상세현황

법인명	상장 여부	최초 취득 일자	출자 목적	지분율	최근사업연도 재무현황	
					총자산 당기순이익	
PSK AMERICA, INC.	비상장	2000년 01월 01일	기술지원	100	22,937	4,469
PSK Asia, Inc., Ltd.	비상장	2003년 12월 19일	해외판매 촉진	100	29,581	8,709
PSK(CHINA)CO.,LTD.	비상장	2013년 08월 16일	해외판매 촉진	100	15,480	2,341
PSK(Shanghai) Semiconductor Co., Ltd	비상장	2017년 03월 28일	해외판매 촉진	100	36,263	8,609
PSK Japan Inc.	비상장	2020년 12월 04일	해외판매 촉진	100	8,384	1,446
에스이앤에스(주)	비상장	2021년 05월 03일	국내 장비 셋업	100	1,721	79
에스이앤티(주)	비상장	2021년 05월 03일	국내 장비 셋업	100	1,620	28
에스이앤아이(주)	비상장	2021년 11월 30일	국내 장비 셋업	100	1,032	78
합 계				-	117,018	25,758

주: 3Q25말 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

주요 사업 및 매출 구성

동사의 주요 장비는
PR Dry Strip로 전사 매출의
약 70~80% 를 차지

동사의 주요 장비는 PR Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Bevel Etch(Edge Clean)가 있다.

PR Strip

PR Dry Strip 장비는 동사 매출액의 약 70~80%를 차지하는 핵심 장비이며 글로벌 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. PR Strip은 반도체 공정에서 회로 패턴 형성을 위해 사용했던 감광액(Photoresist, PR)을 제거하는 Dry Strip 장비이다. 포토레지스트는 반도체 노광 공정에 사용되는 재료로, 빛에 노출되면 성질이 변하여 웨이퍼에 패턴을 형성할 수 있게 한다. 노광 공정은 포토레지스트 코팅 → 노광 → 현상 → 식각 → PR 제거 순으로 진행되며 동사의 PR Strip 장비는 PR 제거에 사용된다. PR의 주성분은 Carbon으로 O₂ 플라즈마를 사용해서 제거한다. 산소(O₂) 가스를 플라즈마 상태로 만들어 반응성이 높은 산소 라디칼(Oxygen Radical)을 생성한다. 이 라디칼이 고체 상태인 PR(탄소 화합물)과 만나 화학 반응을 일으켜 기체 상태인 이산화탄소(CO₂)와 수증기(H₂O)로 변하게 하여 제거한다. 동사 장비는 DRAM, NAND, Logic 반도체에 모두 적용되며 경쟁사로는 Mattson Technology(미국), Lam Research(미국) 등이 있다.

Dry Cleaning

웨이퍼 표면상의 자연 산화막, 유기물, 파티클 등을 증착 공정 전에 플라즈마 기반으로 제거하는 건식 세정장비이다. 싱글 웨이퍼 처리장비로 High Aspect Ratio Contact(HARC) 세정 및 패턴 형성이 가능하다. 미세화된 패턴 사이의

세정액 잔류 및 패턴 도괴(Pattern Collapse) 문제를 해결하기 위해 습식 세정장비(Wet Cleaning)를 대체하는 장비로 DRAM에 사용되고 있다. DRAM 미세화 전환에 따라 수요가 확대되고 있다. 주요 경쟁사로는 Applied Materials(미국)가 있다.

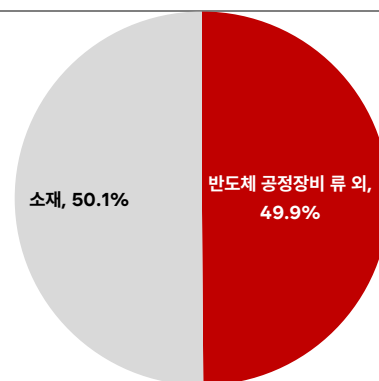
New Hard Mask Strip

NAND용 장비로 Hard Mask를 제거하기 위한 장비이다. Hard Mask는 패턴닝에 필요한 필름으로 서로 다른 두 개의 박막 필름을 제거하는 속도의 차이를 이용하여 식각하는 방법이다. PR Mask만으로는 식각 공정에서 가로에 대한 세로 비율이 커지는 높은 종횡비 구조를 지탱하기 어렵고 쓰러지는 현상이 발생하게 됨으로 PR Mask 아래 Hard Mask를 지지층으로 사용한다. 이런 Hard Mask는 식각 후 전통적인 제거 공정으로는 제거되지 않는 문제점이 있다. 동사 장비는 산화막 및 질화막과 같은 하드마스크의 하부막들에 대하여 선택적으로 제거할 수 있는 높은 선택비가 장점이다. 특히 3D NAND가 300단 이상으로 높아지면서 하드마스크 두께가 두꺼워짐에 따라 수요가 급증하고 있다.

Bevel Etch

웨이퍼 가장자리(Bevel 또는 Edge) 부분의 잔류물과 파티클을 제거하는 장비이다. 반도체 공정이 진행되는 동안 웨이퍼 엣지에는 여러 층이 증착된다. 이 층들은 제조공정 중 변형 및 탈착되어 입자 형태로 웨이퍼 상부에 손상을 초래하게 되고 이러한 결함은 웨이퍼 중심부로 이동해 수율 저하를 유발한다. Bevel Etch 장비는 이를 해결하기 위해 웨이퍼 가장자리의 유전체(Dielectric), 금속(Metal), 유기물(Organic Material) 등 다양한 막질을 제거하는 장비로 웨이퍼 가장자리의 수율을 향상시킨다.

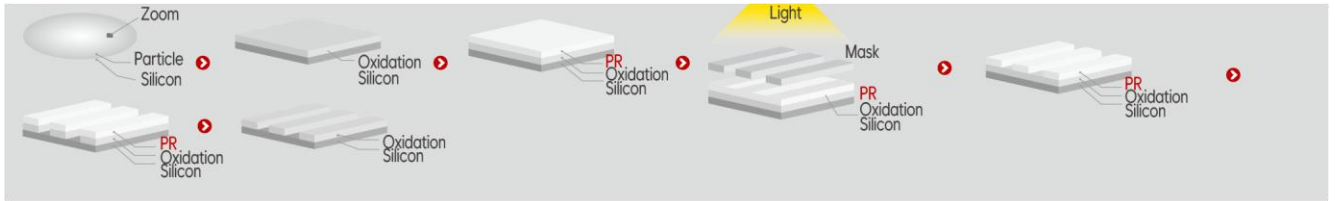
피에스케이 매출 비중



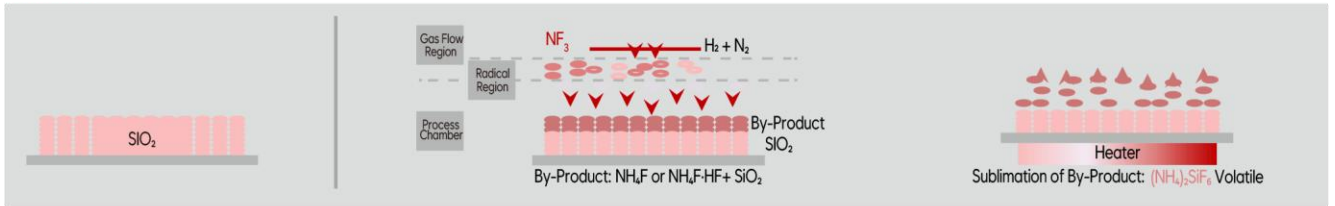
주: 3Q25 누적기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

피에스케이 장비별 공정

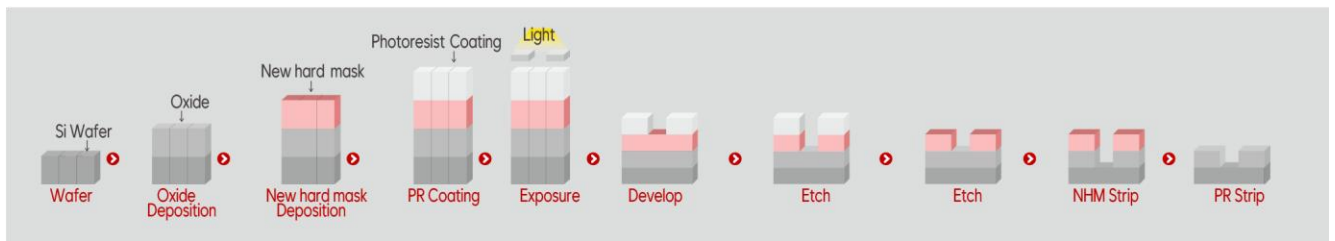
PR Strip



Dry Cleaning



NHM Strip



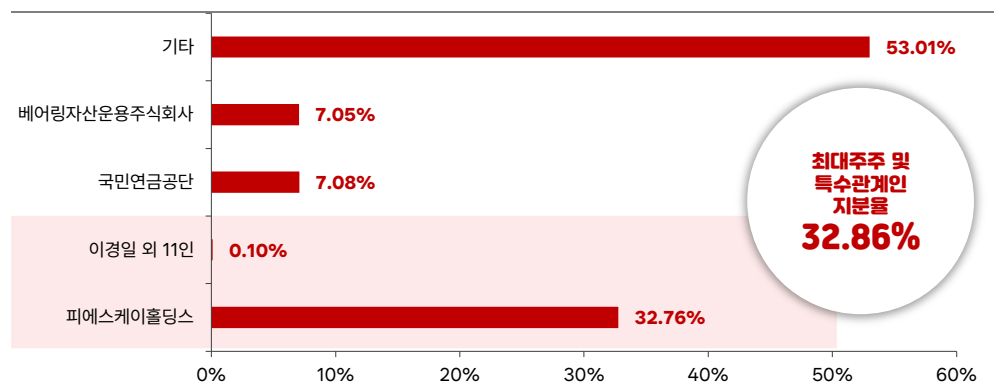
자료: 피에스케이, 한국IR협회의 기업리서치센터

주주 구성

**최대주주는 피에스케이홀딩스로,
지분율 32.76% 보유**

피에스케이 최대주주는 피에스케이홀딩스로, 지분 32.76%를 보유하고 있으며, 피에스케이홀딩스를 포함한 최대주주 및 기타특수관계인 지분의 합은 32.86%이다. 피에스케이홀딩스는 2019년 4월 1일 존속회사, 신설회사로 인적분할하고 존속법인은 피에스케이홀딩스로, 신설법인은 피에스케이로 사명을 정하였다. 피에스케이는 전공정 반도체 장비 중심, 피에스케이홀딩스는 후공정 장비 중심의 사업을 영위하고 있다.

피에스케이 주주 현황



주: 3Q25말 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

산업 현황

1 반도체 투자 비중이 높은 전공정 장비

반도체 장비는 전공정/후공정,
가스 공급 등 보조 장비로 구분

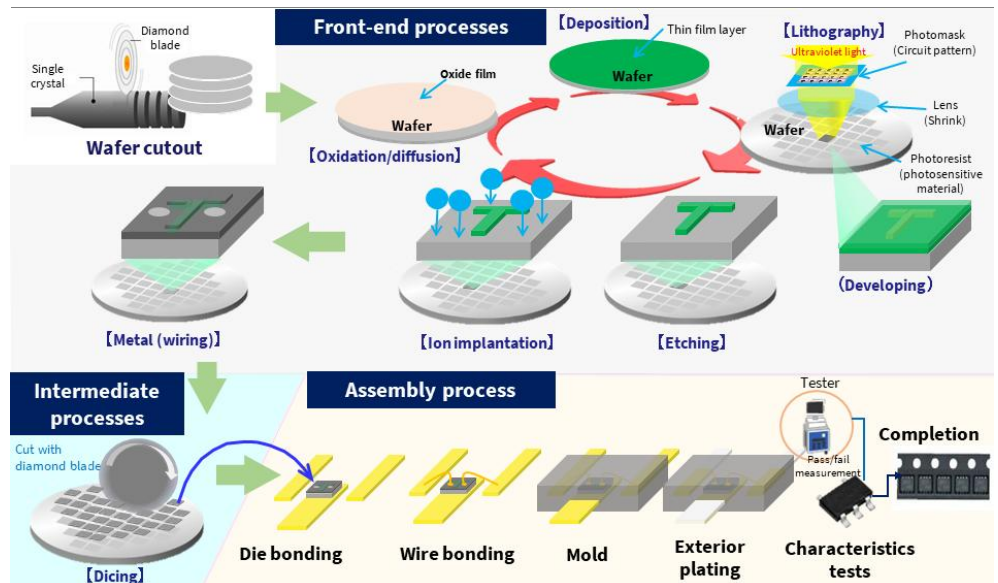
반도체 장비는 회로 설계, 실리콘 웨이퍼 제조 등 준비 단계부터 웨이퍼 가공, 칩 패브리케이션, 조립 및 테스트에 이르는 전체 제조 공정을 포괄하는 개념이다. 공정별로 분류하면, 전공정 장비(웨이퍼 가공), 후공정 장비(조립 및 검사), 그리고 가스 공급, 웨이퍼 트랜스퍼, 건조 등 보조 역할을 하는 관련 장비로 구분된다.

전공정 장비는 실리콘 웨이퍼를 통해 칩을 형성하는 핵심 공정에 투입되며, 국내 시장에서 전체 장비 수요의 약 70%를 차지하고 수입 의존도가 높다. 주요 구성으로는 노광장비, Photo Resist 코터, 디벨로퍼, 산화 및 확산 처리 장비, 이온 주입(Implantation) 장비, 식각 장비, CVD, PVD 증착 시스템, CMP 평탄화 장비, 세정, 건조 장비, 그리고 Wafer-level 검사 장비가 포함된다.

후공정 장비는 전공정 완성 칩의 조립과 신뢰성 검증을 담당하며, Dicing Saw 장비(웨이퍼 절단), Die Bonding 장비(다이 부착), Packaging 장비(패키징), 그리고 Burn-in Tester, Package Tester, Prober, Test Handler 등의 검사용 장비로 구성된다. 이들 장비는 칩의 리드 프레임 연결과 단계별 불량 스크리닝을 통해 안정성을 확보한다.

반도체 장비 산업은 표준화된 제품이 아닌, 고객의 공정 스펙에 맞춘 주문 생산 시스템을 기반으로 한다. 동일 고객이라도 생산 라인별 최적화 요구가 상이하므로, 소자 업체와의 기술 협력 및 공동 개발을 통해 맞춤형 솔루션을 적시에 공급해야 경쟁력을 유지할 수 있다.

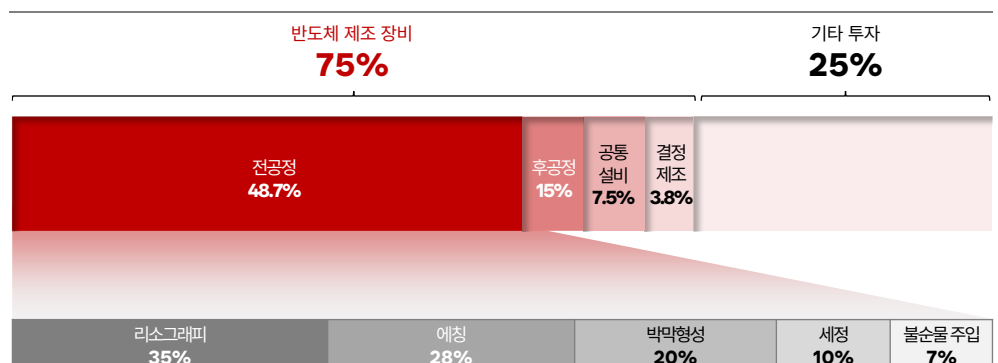
반도체 주요 공정



주: 1) Front-end processes - Wafer cutout: 잉곳에서 웨이퍼 절단, Oxidation/diffusion: 산화막 형성, Deposition: 박막 증착, Lithography: 회로 패턴을 포토레지스트에 전사, Developing: 노광된 포토레지스트 현상, Etching: 식각, Ion implantation: 이온 주입으로 전기적 특성 부여, Metal (wiring): 금속 배선 형성, 2) Intermediate processes - Dicing: 웨이퍼를 개별 칩으로 절단, 3) Assembly process- Die bonding: 칩을 기판에 부착, Wire bonding: 금선으로 칩과 기판 연결, Mold: 칩을 보호하는 몰딩 수지 성형, Exterior plating: 외부 단자 도금, Characteristics tests: 전기적 특성 검사, Completion: 최종 완제품
자료: Toshiba, 한국IR협회의 기업리서치센터

반도체 투자 설비에서 반도체 제조 장비는 약 75%를 차지하며 전공정이 전체 반도체 투자 설비의 약 48.7%, 후공정이 약 15%를 차지한다. 전공정 장비 내에서는 노광 35%, 식각 28%, 증착 20%, 세정 10% 등의 비중을 보인다. 미세화와 기술 복잡성 증가로 인해 노광과 식각의 비중이 늘어나는 추세를 보인다. 노광은 3nm 이하 공정에서 EUV(극자외선) 장비의 필수적 도입으로 비용이 급증하며 과거 20% 대 비중에서 최근 35%대로 확대되었다. 식각은 3D NAND 고단화, 공정 반복 증가에 따라 수요가 확대되고 있다. 후공정은 테스트, 조립, 패키징을 포함하며 첨단 패키징 수요 증가로 비중이 상승 중이다.

반도체 CAPEX 비중



자료: 업계자료, 한국IR협회의 기업리서치센터

반도체 장비 시장 전망

**AI 투자 확대에 따른 첨단
로직·메모리 수요 증가로
2026~2027년 글로벌 반도체
장비 시장 성장 기대**

AI 관련 투자에 따라 최첨단 로직, 메모리 및 선단 패키징 기술 도입에 힘입어 반도체 제조업체의 반도체 설비 투자는 증가세를 보이고 있다. 2025년 글로벌 반도체 장비 매출은 전년 대비 13.8% 성장한 1,333억 달러로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상된다. 이와 같은 성장세는 향후 2년간 지속될 것으로 보여 2026년에는 1,456억 달러(+9.3% YoY), 2027년 1,561억 달러(+7.2% YoY)에 달할 것으로 전망된다(SEMI).

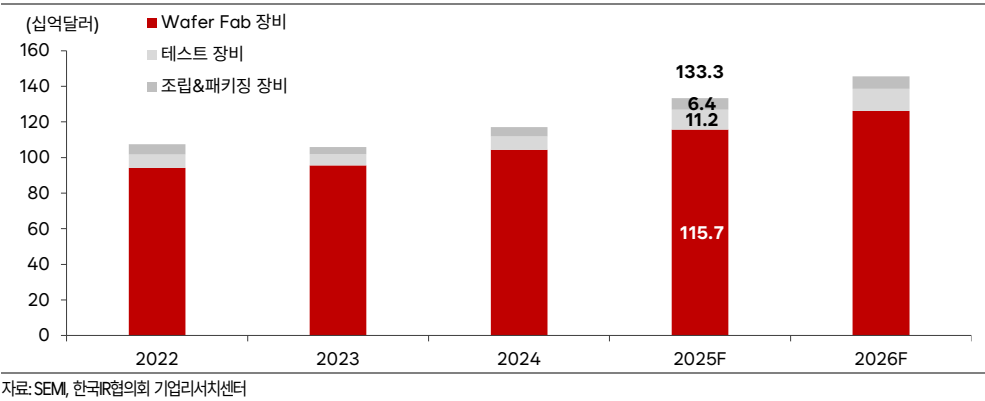
웨이퍼 처리, 펌 시설, 마스크 및 레티클 장비를 포함하는 웨이퍼 펌 장비(WFE) 부문은 2025년 1,157억 달러로 전년 대비 11.0% 성장할 것으로 전망된다. 이는 AI 지원을 위한 DRAM 및 HBM 관련 투자가 예상보다 강하게 나타난데 기 인한다. 중국의 지속적인 CAPA 확대 또한 장비 수요 증가의 큰 요인 중 하나이다. WFE 부문은 선단 로직 및 메모리 투자 확대에 따라 2026년 +9.0% YoY, 2027년 +7.2% YoY 성장할 것으로 예상된다.

후공정 장비는 2024년부터 시작된 강한 회복세가 지속될 것으로 예상된다. 테스트 장비는 2024년 전년 대비 20.3% 성장하며 강한 회복세를 보인데 이어 2025년에도 48.5% 급증하며 112억 달러에 이를 것으로 전망된다. 조립 및 패키징 장비는 2024년 전년 대비 32.8%의 큰 폭의 성장세를 기록하였으며 2025년에는 전년 대비 19.6% 성장한 64억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 후공정 장비 부문 성장은 지속되어 테스트 장비는 2026년 +12.0% YoY, 2027년 +7.1% YoY 증가가 전망된다. 조립 및 패키징 장비는 2026년 +9.2% YoY, 2027년 +6.9% YoY 성장할 것으로 예상된다. 자동차, 산업 및 소비자 시장의 지속적인 약세에도 불구하고 디바이스 아키텍처의 복잡성이 증가와 AI 및 HBM 반도체의 스펙 향상이 후공정 장비 시장 성장을 견인하고 있다.

파운드리 및 로직용 WFE 매출은 선단 노드에 대한 견조한 투자로 인해 2025년 전년 대비 9.8% 성장한 666억 달러가 예상되며 AI 가속기, 고성능 컴퓨팅 및 프리미엄 모바일 프로세서 CAPA 확대에 의한 성장이 지속될 것으로 전망된다. 업계가 2nm GAA 대량 양산으로 전환함에 따라 최첨단 기술에 대한 투자가 집중될 것으로 보인다. 이에 따라 2026년에는 +5.5% YoY, 2027년 +6.9% YoY 성장이 예상된다.

메모리 관련 자본 지출은 HBM 수요 증가와 테크 마이그레이션에 따라 2027년까지 확장세를 보일 것으로 전망된다. DRAM은 공급 업체들의 HBM 생산 확대와 선단 노드로의 미세화 전환에 따라 2025년 +15.4% 성장한 225억 달러, 2026년 +15.1% YoY, 2027년 +7.8% YoY 성장세를 보일 것으로 예상된다. NAND는 3D NAND 적층 확대와 생산 능력 확대에 따라 2025년 140억 달러(+45.4% YoY), 2026년 157억 달러(+12.7% YoY), 2027년 169억 달러(+7.3% YoY)에 이를 것으로 전망된다.

글로벌 반도체 장비 시장 규모 추이





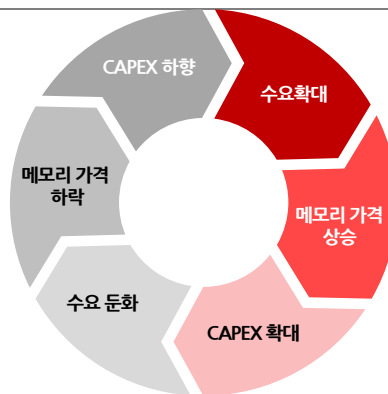
투자포인트

반도체 Cycle과 주가 동행하는 전공정 장비주

메모리 업사이클에서 대형주와
전공정 장비주는 강한 주가
상관관계 확인, 현재 AI 수요
강세와 메모리 가격 급등에 따른
CAPEX 확대 국면에서 전공정
장비주 주가 동반 상승 기대

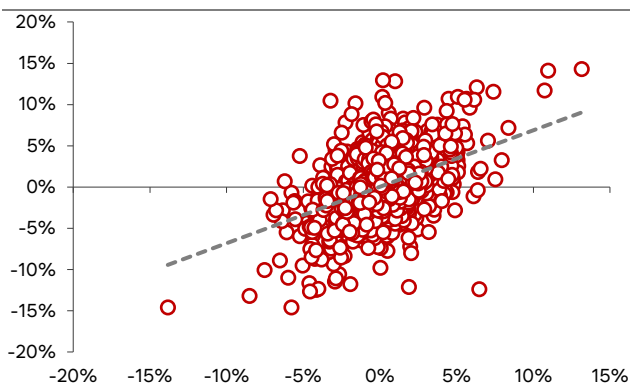
반도체 업사이클은 장비주 주가에 가장 긍정적인 영향을 끼친다. 통상적으로 메모리 반도체 업황은 수요 확대 → 메모리 가격 상승 → CAPEX 확대 → 수요 둔화 → 메모리 가격 하락 → CAPEX 하향 → 수요 확대의 Cycle이 반복된다. 현재 메모리 업황은 AI를 중심으로 한 수요 강세 속, 공급 부족으로 메모리 가격이 급등세를 보이고 있고 이로 인해 메모리 생산 업체의 가파른 실적 증가 및 주가 상승을 보이고 있다. 또한 수요 대응을 위해 CAPEX가 상향되고 있는 구간이다. 역사적으로 반도체 Sub Sector 중 대형주와 주가 상관관계가 가장 높은 것은 전공정 장비주이다. 2008년 이후 삼성전자, SK하이닉스와 전공정 장비주의 주가 상관계수는 0.97로 매우 강한 양의 상관관계를 보인다. 즉 반도체 업사이클로 대형주의 주가 상승 구간에서는 전공정 장비주의 주가도 동반 상승하였음을 의미한다. 이는 반도체 산업의 수익 창출과 설비 투자가 강하게 커플링 되어 있음을 보여준다.

메모리 반도체 Cycle



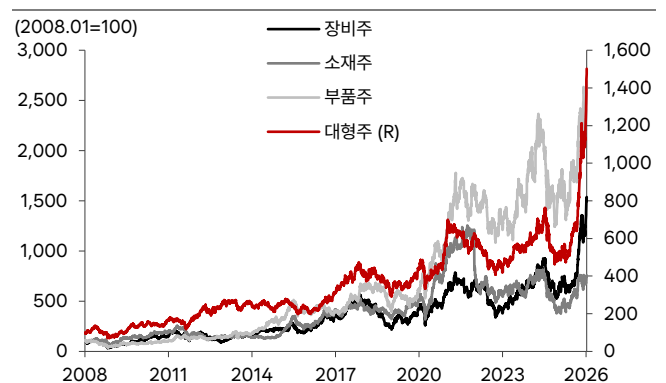
자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

반도체 대형주와 장비주 주가 상승률 상관 관계



주: 1) 반도체 대형주-삼성전자, SK하이닉스 2개사, 2) 장비주-원익PS, 주성엔지니어링, 피에스케이 등 9개사
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

반도체 대형주 및 Sub Sector 상대 주가 추이



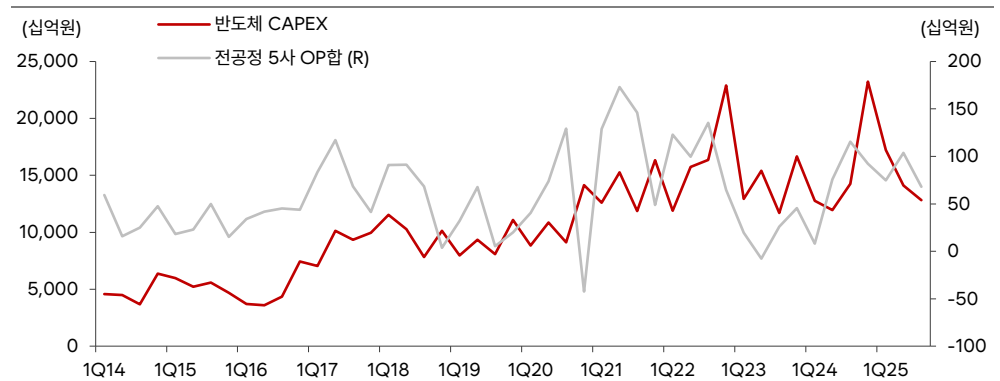
주: 1) 반도체 대형주-삼성전자, SK하이닉스 2개사, 2) 장비주-원익PS, 주성엔지니어링, 피에스케이 등 9개사,
3) 소재주-한솔케미칼 등 6개사, 부품주-티씨케이 등 5개사
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

반도체 CAPEX는 장비주 실적

메모리 업사이클에서 CAPEX
증가는 전공정 장비주 실적 개선과
주가 상승으로 이어지며,
2026년은 2018년 대비
제한적인 DRAM CAPA 증가와
HBM4의 높은 웨이퍼 소요량으로
공급 과잉 우려 낮아
장비주 강세 지속 전망

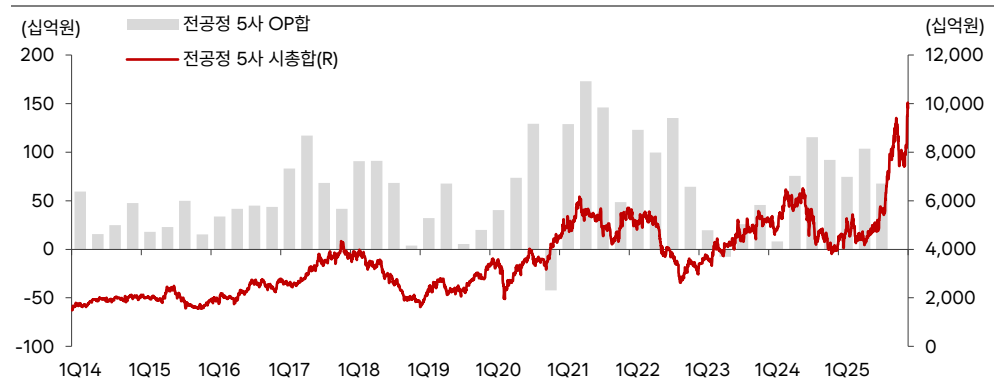
앞서 언급한 바와 같이 메모리 업사이클에서 대형주와 전공정 장비주의 주가는 동행성을 보인다. 메모리 생산업체 입장에서 수요 증가에 대응을 위한 CAPEX 집행을 확대하게 되는데 CAPEX는 장비업체의 매출로 인식이 되며 실적 개선으로 이어진다. 주가가 실적과 밸류에이션의 함수라는 측면에서 실적 개선은 주가 상승으로 나타난다. 보통 주가는 CAPEX 집행을 선반영함으로 실제 CAPEX 집행 시기 대비 주가가 1~2분기 빠르게 움직이나, 전반적으로 반도체 CAPEX 증가 구간에서 장비주 주가 상승은 구조적 귀결이다. 2026년에도 전공정 장비주의 강세를 전망하는 이유이다. 보통 사이클의 종료는 공급이 증가하는 구간에서 수요가 감소하며 발생한다. 과거 2016~2017년 반도체 슈퍼사이클의 종료는 삼성전자의 대규모 DRAM CAPA 증가 구간에서 서버 수요가 감소하며 나타났다. 한 해에만 145K/월 CAPA 증가를 보였던 2018년과 달리 현재는 약 100K월 규모의 DRAM CAPA 증가가 연말까지 예상되며, HBM4의 DDD5 대비 Net Die Penalty가 4배에 달하는 만큼 HBM 생산 allocation 증가가 범용 DRAM CAPA를 잠식하기 때문에 공급 증가는 여전히 제한적일 것으로 판단된다.

반도체 CAPEX 및 전공정 5사 합산 영업이익 추이



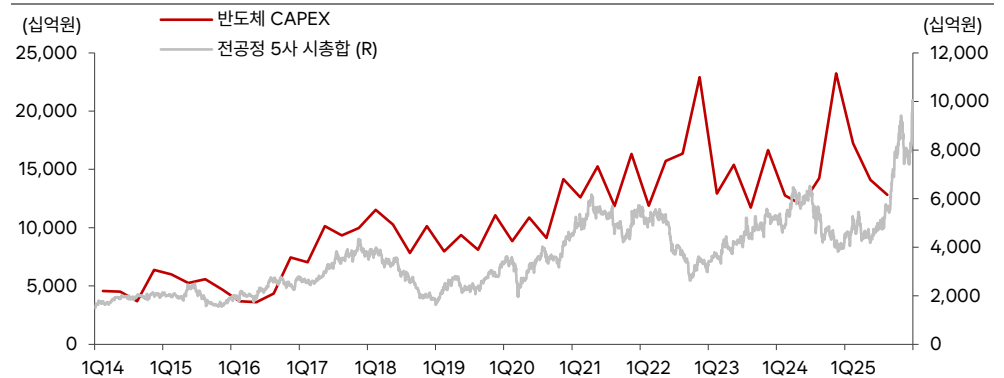
주: 전공정 5사-원익PS, 유진테크, 주성엔지니어링, 케이씨텍, 테스
자료: WiseFN, 한국IR협회의 기업리서치센터

전공정 5사 합산 영업이익 및 합산 시가총액 추이



주: 전공정 5사-원익PS, 유진테크, 주성엔지니어링, 케이씨텍, 테스
자료: WiseFN, 한국IR협회의 기업리서치센터

반도체 CAPEX 및 전공정 5사 합산 시가총액 추이



주: 전공정 5사-원익PS, 유진테크, 주성엔지니어링, 케이씨텍, 테스
자료: WiseFN, 한국IR협회의 기업리서치센터

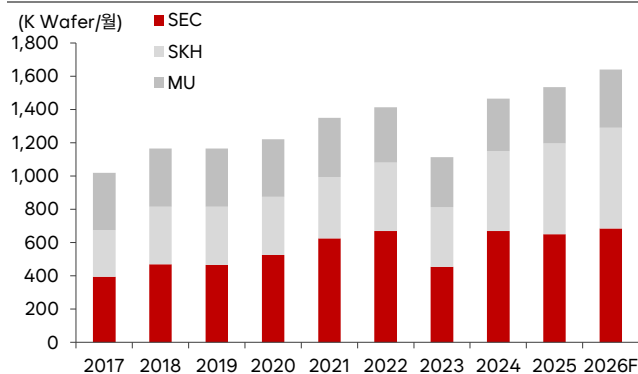
DRAM 및 Logic 선단 공정 중심 CAPA 확대 기대

**삼성 SK하이닉스의 HBM 중심
DRAM 1c nm 투자와
삼성 Intel의 첨단 파운드리 투자
확대로 PR Strip 장비 수요 증가
전망, 미중 갈등 영향으로
북미 파운드리 공급 확대 기대**

반도체 CAPEX 투자 증가에 따른 동사 장비 수요 확대가 기대된다. 2026년 반도체 업체의 투자는 DRAM 및 로직 선단 공정 중심으로 이루어질 전망이다. 우선 삼성전자는 P4 Ph3에 2025년 말부터 장비 반입을 시작하였고 2026년 내 가동 예정이다. 기존 Foundry 라인으로 예정되어 있던 Ph2는 HBM4 대응을 위해 DRAM으로 설계 변경되어 DRAM 1c nm 중심 투자 예정이다. 상반기 인프라 투자 완료 후 하반기 장비 입고가 예상된다. 연내 공급에 미치는 영향은 매우 제한적이다. 삼성전자는 그 밖의 Fab에서 미세화 전환이 예상된다. SK하이닉스는 M15x에 4Q25부터 장비 반입이 시작되었고 HBM을 위한 1b nm DRAM으로 4Q25년까지 연내 투자가 지속될 전망이다. 잔여 공간에는 연말 투자가 예상된다. M16, M14 팹에서 1c nm로 전환 투자도 이루어질 것으로 보인다. 2027년에는 용인 Y1 Fab 투자가 예상된다. 클린룸이 제한적인 Micron은 기존 Fab의 전환 투자 중심이 될 예정이다. 2027년 신규 Fab에 클린룸 조성이 진행될 예정이다. 비메모리의 경우 삼성전자의 미국 Taylor Fab에서 2nm 및 4nm 첨단 파운드리 라인 투자가 예상된다. Intel은 Arizona Fab52에 18A 공정 중심의 투자가 꾸준히 이루어질 전망이다.

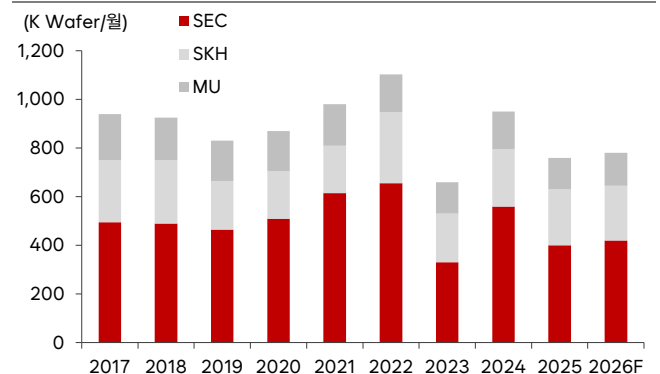
고객사들의 투자 확대로 PR Strip 장비를 중심으로 한 장비 공급이 확대될 것으로 보인다. 메모리와 비메모리 모두 선단 공정 중심의 투자가 예상되며, 선단 공정에서의 노광 공정의 증가로 PR Strip 장비의 수요도 CAPA 단위당 확대될 것으로 보인다. 특히 북미 파운드리 투자는 미중 무역 갈등에 따른 중국 장비 배제 움직임으로 반사 수혜를 받을 것으로 기대된다. 동사는 Mattson Tech와 PR Strip에서 경쟁 관계에 있다. Mattson은 1988년 미국에서 설립되었으나 2016년 베이징 정부 소유의 투자 회사인 Beijing E-Town Dragon Semiconductor Industry Investment Center가 약 3억 달러에 인수하였다. 시장에서 중국 장비 회사로 인식되고 있다. 동사는 2025년 Texas Instruments를 신규 고객사로 확보한 것도 이와 같은 변화 움직임이 반영된 결과라 판단된다. 메모리 및 비메모리 고객사들의 투자가 2026년에 그치지 않고 2027년에도 신규 Fab 투자가 지속될 것으로 보이는 만큼 2027년에도 동사 실적 성장이 가능할 것으로 전망된다.

DRAM CAPA 전망



자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

NAND CAPA 전망



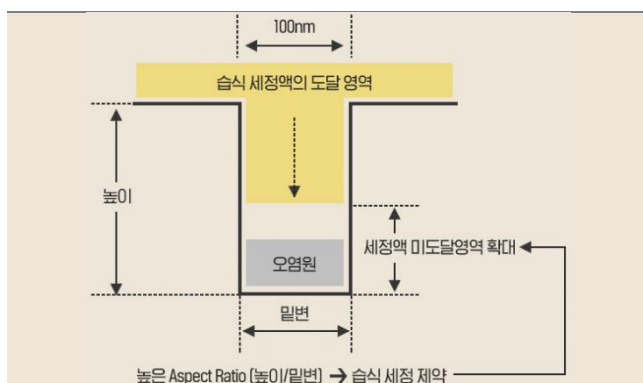
자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

4 신규 Dry Cleaning 장비 개발 중

DRAM 업황 강세에 따라 New Dry Cleaning 장비 개발을 우선 추진, Bevel Etcher는 중국 매출 감소에도 국내 메모리 고객사 공급 확대로 점유율 회복 중

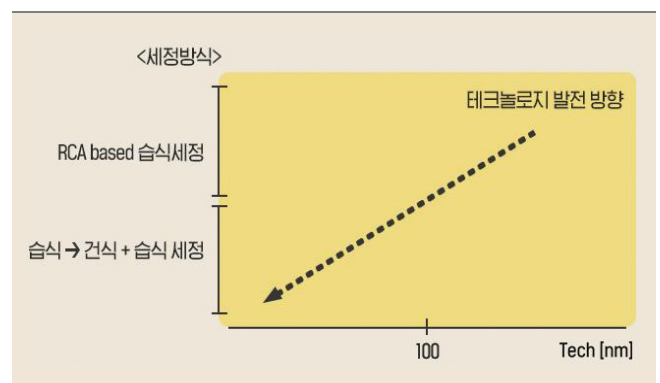
PR Strip을 제외한 장비군에서는 세정장비의 성장이 기대된다. 동사는 Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Bevel Etch 장비 포트폴리오를 보유하고 있고 Meta Etcher 장비는 개발 중이다. 당초 2025년 개발 완료될 것으로 예상되던 Metal Etcher의 개발은 다소 지연될 것으로 예상된다. 현재 DRAM의 업황 강세에 따른 건식세정 장비에 대한 수요 증가로 신규 건식세정 장비 개발이 우선되기 때문이다. 동사는 고객사 DRAM 미세화에 대응이 가능한 New Dry Cleaning 장비의 개발을 연내 마무리하여 고객사 쿨을 진행할 예정으로 2027년 매출 발생이 기대된다. Bevel Etcher는 2Q24부터 중국 DRAM 업체로 공급을 확대하였으나 중국의 국산화 정책으로 Naura Tech의 점유율이 확대된 영향으로 2025년 매출 감소를 보였다. 2024년 전사 매출액의 약 10%를 차지하던 Bevel Etcher의 매출 비중은 2025년 5%로 하락한 것으로 파악된다. 동사는 국내 메모리 고객사향으로 공급 확대로 점유율을 점진적으로 확대시킬 계획이다. PR Strip 외 장비로의 다변화는 좀더 중장기 관점에서 이루어질 것으로 판단된다.

습식 세정의 한계



자료: SK하이닉스, 한국IR협의회 기업리서치센터

미세화에 따른 세정 방식 변화



자료: SK하이닉스, 한국IR협의회 기업리서치센터

실적 추이 및 전망

1 중국 수요 감소를 국내 수요 증가로 상쇄한 2025년

**2025년 매출액 4,408억
원(+10.7% YoY), 영업이익
933억 원(+11.1% YoY)을 전망**

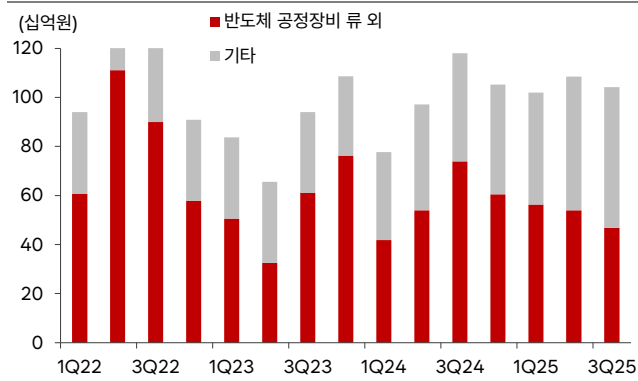
2025년 동사의 실적은 매출액 4,408억 원(+10.7% YoY), 영업이익 933억 원(+11.1% YoY)을 전망한다. 3Q25 누적 매출액과 영업이익은 각 3,145억 원(+7.4% YoY), 666억 원(-9.1% YoY)을 기록했다. 전반적으로 반도체 고객사의 전년 대비 확대된 CAPEX에 기인한다. 삼성전자의 P4 DRAM 투자 및 미세화 전환 투자, Micron의 DRAM 전환 투자와 함께 SK하이닉스는 M14, M16에서 일부 투자를 진행하고 4Q25부터는 M15x 투자가 집행되고 있다. 중국향 수요는 중국의 반도체 국산화 움직임이 강화되며 전년 대비 50% 이상 크게 감소하였다. 중국 국산화 영향은 PR Strip 장비뿐만 아니라 Bevel Etcher에도 미쳤다. 동사는 Mattson Tech와 PR Strip에서, Naura Tech와 Bevel Etch 장비에서 경쟁 관계에 있기 때문이다. 2024년 전사 매출액의 약 10%를 차지하던 Bevel Etcher의 매출 비중은 2025년 5%로 하락한 것으로 파악된다. 2025년 국내 고객사 수요가 중국향 수요 감소분을 상쇄하였고 당초 예상보다 국내 반도체 고객사들의 투자 기조가 확대되며 당사가 2025년 5월 보고서의 매출액 추정치를 약 8% 상회할 것으로 보인다. 수익성 측면에서는 매출액 확대에도 상대적으로 마진이 높은 신규 장비들의 매출 비중이 감소하고 기존 PR Strip 장비의 매출 비중이 오히려 확대되어 전년과 유사한 OPM 21.2%를 기록할 것으로 전망한다.

2 선단 공정 중심 투자로 PR Strip 수요 지속 전망

**2026F 매출액 5,068억
원(+15.0% YoY), 영업이익
1,087억 원(+16.6% YoY)으로
사상 최대 실적 예상**

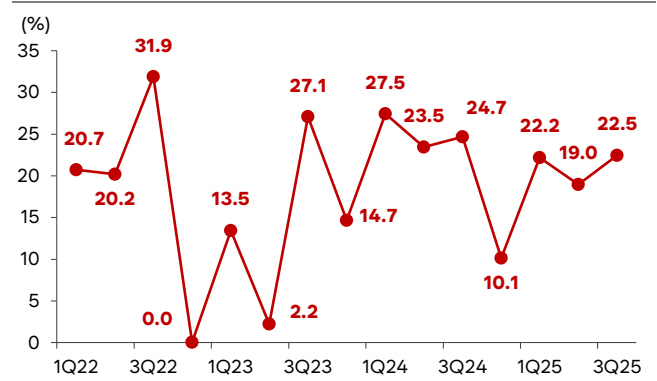
2026F 매출액 5,068억 원(+15.0% YoY), 영업이익 1,087억 원(+16.6% YoY)으로 사상 최대 실적을 예상한다. AI 수요 강세가 지속되며 반도체 고객사의 DRAM 및 비메모리 선단 공정 중심 투자로 PR Strip 장비 중심의 성장이 지속될 것으로 보인다. 삼성전자의 P4, SK하이닉스의 M15x, Micron의 전환투자가 2025년에 이어 집행될 것과 함께 비메모리의 경우에도 삼성전자 Foundry의 Taylor Fab, Intel의 Arizona Fab52 투자가 예상된다. 향후 미국에 투자되는 Fab은 중국 장비 배제 움직임으로 동사가 반사 수혜를 기대할 수 있을 것으로 보인다. 동사의 중국향 매출은 이미 충분히 감소한 수준으로 추가적인 하락 가능성도 제한적이라 판단된다. 전반적으로 DRAM 투자가 전년 대비 확대되며 동사 실적을 견인할 전망이다. DRAM 공급 부족이 극심해지고 있는 만큼 DRAM 업체의 투자 기조도 점진적으로 확대되고 있는 것으로 파악된다. 투자 속도에 따라 하반기 동사의 추가적인 실적 업사이드 가능성도 열려 있다. 다만 기존에 예상하였던 PR Strip 외 장비 다변화는 다소 시간이 소요될 것으로 보인다. 현재 DRAM 수요 대응을 위한 신규 Dry Cleaning 장비의 개발이 우선시되며 Metal Etcher의 개발 시기도 늦어질 것으로 예상된다. 신규 Dry Cleaning 장비는 2027년 매출이 발생할 것으로 전망된다. Bevel Etcher는 중국 수요 감소의 영향을 받았으며 국내 고객사향으로 공급량을 확대할 계획이다. 따라서 2026년에도 PR Strip의 매출 비중이 약 80% 이상을 유지할 것으로 보인다. 장비 매출 비중이 2025년과 유사한 가운데 매출액 증가로 인해 OPM은 전년 대비 0.3%p 증가한 21.5%를 전망한다.

피에스케이 부문별 매출액 추이



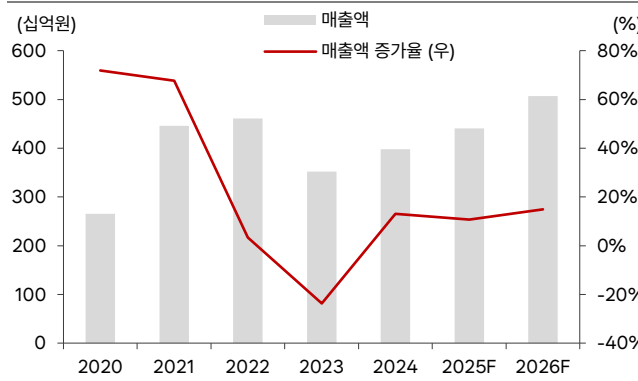
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

피에스케이 분기별 영업이익률 추이



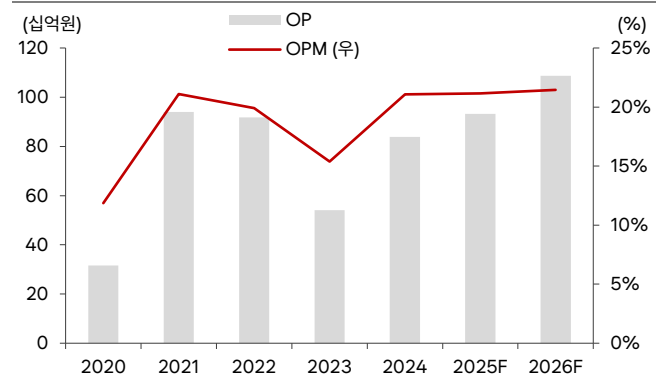
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

피에스케이 매출액 및 매출액 증가율 추이



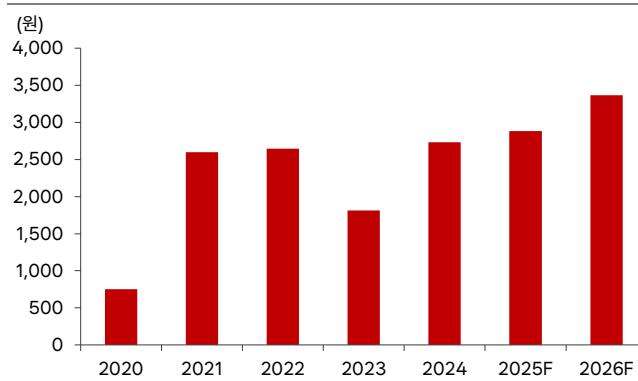
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

피에스케이 영업이익 및 영업이익률 추이



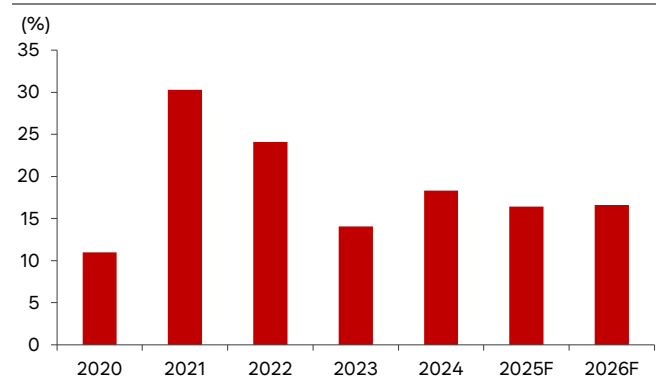
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

피에스케이 EPS 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

피에스케이 ROE 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

피에스케이 부문별 실적

(단위: 십억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	2023	2024	2025F	2026F
매출액	83.7	65.5	94.0	108.7	77.7	97.1	118.0	105.2	102.0	108.5	104.1	351.9	398.1	440.8	506.8
반도체 공정장비 류 외	50.6	32.6	61.1	76.2	41.8	54.0	73.9	60.5	56.3	53.9	46.7	220.5	230.2	240.7	284.5
기타	33.1	33.0	32.9	32.5	35.9	43.1	44.1	44.7	45.7	54.5	57.4	131.4	167.9	200.1	222.3
영업이익	11.3	1.5	25.5	15.9	21.3	22.8	29.1	10.7	22.6	20.6	23.4	54.1	83.9	93.3	108.7
지배주주순이익	11.0	2.5	20.0	19.0	20.6	19.7	23.4	15.4	20.0	18.6	20.6	52.5	79.1	83.5	97.5
Margin(%)															
영업이익률	13.5	2.2	27.1	14.7	27.5	23.5	24.7	10.1	22.2	19.0	22.5	15.4	21.1	21.2	21.5
지배주주순이익률	13.2	3.9	21.3	17.5	26.6	20.2	19.9	14.6	19.6	17.2	19.8	14.9	19.9	18.9	19.2
YoYGrowth(%)															
매출액	-11.0	-51.1	-33.8	19.6	-7.1	48.2	25.6	-3.2	31.2	11.7	-11.8	-23.7	13.1	10.7	15.0
반도체 공정장비 류 외	-16.5	-70.7	-32.0	31.6	-17.4	65.8	20.9	-20.6	34.5	-0.1	-36.8	-31.0	4.4	4.5	18.2
기타	-1.0	103.5	-44.1	-1.6	8.5	30.9	34.2	37.6	27.2	26.4	30.1	-7.1	27.7	19.2	11.1
영업이익	-42.2	-94.6	-43.8	38,727	89.6	1,448.5	14.4	-33.0	6.0	-9.7	-19.7	-41.1	55.1	11.1	16.6
지배주주순이익	-30.7	-88.8	-48.4	16,769	87.0	676.4	17.4	-18.9	-3.3	-5.3	-12.1	-32.2	50.7	5.5	16.8
QoQGrowth(%)															
매출액	-7.9	-21.7	43.4	15.6	-28.5	24.9	21.5	-10.9	-3.1	6.4	-4.0				
반도체 공정장비 류 외	-12.6	-35.7	87.7	24.7	-45.1	29.1	36.9	-18.1	-7.0	-4.1	-13.3				
기타	0.3	-0.4	-0.2	-1.3	10.7	20.1	2.2	1.3	2.3	19.3	5.3				
영업이익	27,338	-86.9	1,630.3	-37.4	34.0	6.7	27.8	-63.3	112.0	-9.1	13.8				
지배주주순이익	9,712.5	-77.1	689.0	-5.0	8.8	-4.8	19.3	-34.4	29.8	-6.7	10.7				

자료: FnGuide QuantilWise, 한국IR협회의 기업리서치센터

Valuation

2026F PER 12.0x

동사의 Valuation 확대를 위해서는 EPS 성장률을 높여야 하며 이를 확대시킬 요소는 장비 포트폴리오 다변화에 있다고 판단

동사의 현재가는 2026F PER 12.0x로 Historical PER Band(5.5x~16.5x) 중상단에 위치해 있다. Peer 업체로는 국내 반도체 전공정 장비 업체들과 미국의 Lam Research, 중국의 Naura Tech를 선정하였다. Peer 업체의 2026F 평균 PER은 23.8x 수준이다. Lam Research는 글로벌 1위 식각 장비 업체로 식각 뿐만 아니라 증착, 세정 등 전공정 장비 포트폴리오가 상대적으로 다변화되어 있고 특히 High Aspect Ratio 분야에서 독보적인 위치를 점하고 있다. 이와 같은 시장 지배력으로 2026F PER 37.7x의 높은 Valuation을 부여받고 있다. Naura Tech는 중국 반도체 굴기 정책의 최대 수혜 업체로 중국 시장 국산화 기대감이 2026F PER 39.1x의 높은 Valuation의 이유이다. 동사는 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업이나 상대적으로 니치 마켓 중심으로 두 회사와의 Valuation 비교는 다소 어렵다 판단된다.

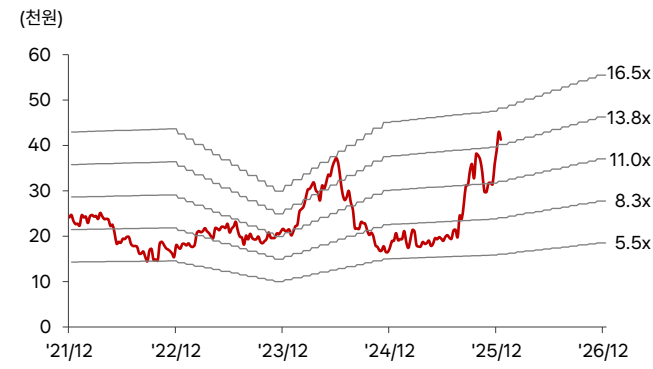
해외 기업을 제외한 국내 Peer 업체의 2026F 평균 PER은 18.0x 수준이다. 동사와 유사한 Valuation 수준을 보이는 기업은 테스와 케이씨텍이며 피에스케이의 2026년 EPS 성장률이 16.3% 이듯 두 업체 역시 약 22%의 EPS 성장률이 예상된다. EPS 성장률이 73%, 94%로 높은 원익PS(28.0x)와 유진테크(20.3x)가 상대적으로 높은 Valuation을 부여받고 있다. 높은 EPS 성장률은 미래 기대감을 높이는 요소로 통상적으로 PER이 높게 형성된다. 결국 동사의 Valuation 확대를 위해서는 EPS 성장률을 높여야 하며 이를 확대시킬 요소는 장비 포트폴리오 다변화에 달렸다고 판단된다. 동사는 2021년 Bevel Etcher 개발로 장비 다변화 기대감이 확대되었으나 중국 수요 감소 등으로 단기적인 성장이 주춤한 상태다. 다만 국내 고객사향으로 공급을 확대할 계획으로 점진적으로 시장 점유율이 증가할 것으로 보인다. 2027년에는 신규 Dry Cleaning 장비 판매가 예상되고 이후 Metal Etcher 개발시 PR Strip을 제외한 장비군으로의 포트폴리오 확대 효과가 이루어질 가능성이 높다 판단된다. 신규 공정으로의 장비 진입은 장비사에 있어 고객사의 CAPA 단위 당 매출액을 확대할 수 있는 요인이기 때문이다.

동종 업종 밸류에이션

피에스케이	종가 (원, 달러)	시가총액 (십억원, 백만달러)	매출액(십억원, 백만달러)			PER(배)			PBR(배)		
			2024	2025F	2026F	2024	2025F	2026F	2024	2025F	2026F
코스피	4,886	3,917,159	3,752,926	3,048,575	3,339,654	-	16.8	10.5	-	1.6	1.4
코스닥	976	533,559	334,116	112,803	130,521	-	42.4	23.6	-	3.2	2.8
피에스케이	40,050	1,160	398	441	507	6.0	12.9	12.0	1.0	2.0	1.8
원익PS	74,800	3,671	748	929	1,197	52.9	48.6	28.0	1.2	3.8	3.4
유진테크	79,400	1,820	338	368	544	11.34	40.0	20.3	1.7	4.0	3.4
주성엔지니어링	31,200	1,475	409	318	425	13.2	29.0	15.4	2.4	2.4	2.1
케이씨텍	38,650	800	385	381	439	10.3	15.9	13.1	1.1	1.5	1.3
테스	48,650	962	240	324	386	7.2	15.7	13.1	0.8	2.2	1.9
NauraTechnology(중국)	514	53,469	4,066	5,679	7,163	37.0	51.8	39.1	6.7	9.2	7.6
LamResearch(미국)	223	279,354	16,670	19,868	22,931	23.4	45.4	37.7	12.5	23.9	18.2
동종업종 평균						22.2	35.2	23.8	3.8	6.7	5.4

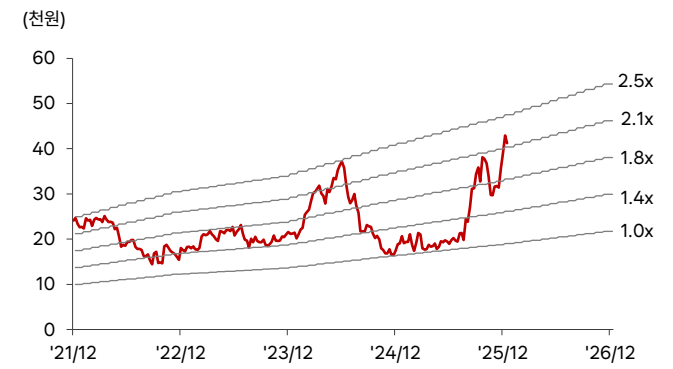
주: 1) 2026년 1월 20일 종가 기준. 동종그룹 25F, 26F는 시장 컨센서스 사용, 2) Lam Research는 CY기준
자료: FrnGuide QuantWise, Refinitiv, 한국IR협회의 기업리서치센터

피에스케이 PER Band



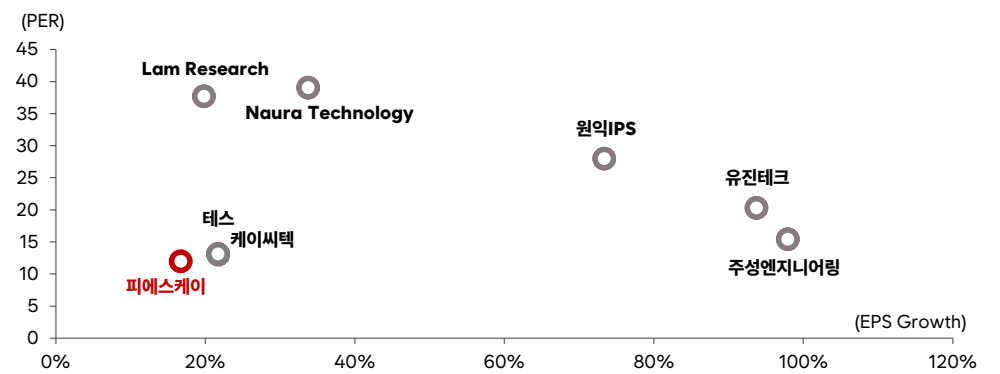
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

피에스케이 PBR Band



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

Peer 업체 PER 및 EPS 성장률



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

⚠️ 리스크 요인

1 더딘 장비 다변화

PR Strip 중심의 니치 시장 의존도 높고 Bevel Etcher 경쟁 심화 Metal Etcher 개발 지연으로 장비 다변화가 더디게 진행되어 CAPEX 단위당 매출 확대는 중장기 과제로 남아있는 점은 리스크 요인

동사의 Risk는 더딘 장비 다변화이다. 2025년 당사가 언급한 Risk 요소는 미국의 對중국 반도체 제재 강화와 이에 따른 중국의 반도체 투자 위축 가능성, 그리고 장비 국산화 가속화는 동사의 중국향 매출 감소 여부였다. 중국은 미중 갈등을 대응하여 반도체 국산화를 진행하였고 이를 통해 Naura Tech와 같은 기업이 빠르게 성장하였다. 중국의 반도체 국산화 움직임이 강화되며 전년대비 50% 이상 크게 감소하였다. 하지만 중국향 매출은 이미 충분히 감소한 수준인 만큼 2026년 추가적인 하락 가능성도 제한적이라 판단된다. 동사 실적에 기여하는 비중이 감소한 만큼 리스크 요인으로 보기에는 어렵다. 결국 중국을 제외한 시장에서의 고객사의 CAPA 투자 증가율을 상회하는 실적 성장을 위해서는 장비 다변화가 필수적이다. 동사가 PR Strip 시장에서 글로벌 1위이나 니치한 시장이다. 따라서 Bevel Etcher와 Metal Etcher 등으로 다변화를 시도 중이나 이는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다. Bevel Etcher는 중국 시장에서 Naura Tech와의 경쟁 심화로 매출액이 오히려 감소하였고, Metal Etcher의 개발은 당초 예상보다 지연되고 있다. 신규 Dry Cleaning 장비의 매출 기여는 2027년, Metal Etcher의 개발 완료는 그 이후가 될 것으로 보인다. 따라서 PR Strip 외 장비로의 다변화에 좀 더 시간이 필요하며 반도체 투자 CAPEX 단위당 매출액 확대도 지연될 개연성이 있어 보인다.

포괄손익계산서

(억원)	2022	2023	2024	2025F	2026F
매출액	4,609	3,519	3,981	4,408	5,068
증가율(%)	3.4	-23.7	13.1	10.7	15.0
매출원가	2,476	1,873	1,885	2,244	2,737
매출원가율(%)	53.7	53.2	47.3	50.9	54.0
매출총이익	2,134	1,646	2,096	2,164	2,331
매출이익률(%)	46.3	46.8	52.7	49.1	46.0
판매관리비	1,215	1,105	1,257	1,232	1,244
판매비율(%)	26.4	31.4	31.6	27.9	24.5
EBITDA	976	603	925	1,044	1,198
EBITDA 이익률(%)	21.2	17.1	23.2	23.7	23.6
증가율(%)	-1.8	-38.2	53.5	12.9	14.7
영업이익	918	541	839	933	1,087
영업이익률(%)	19.9	15.4	21.1	21.2	21.5
증가율(%)	-2.4	-41.1	55.1	11.1	16.6
영업외손익	82	118	135	94	112
금융수익	253	217	246	185	203
금융비용	183	109	114	87	87
기타영업외손익	13	10	3	-4	-4
종속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	1,000	659	974	1,026	1,199
증가율(%)	-0.4	-34.1	47.8	5.3	16.9
법인세비용	226	134	183	195	233
계속사업이익	774	525	791	831	966
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	774	525	791	831	966
당기순이익률(%)	16.8	14.9	19.9	18.9	19.1
증가율(%)	0.9	-32.2	50.7	5.0	16.3
지배주주지분 순이익	774	525	791	831	966

현금흐름표

(억원)	2022	2023	2024	2025F	2026F
영업활동으로인한현금흐름	463	503	672	719	897
당기순이익	774	525	791	831	966
유형자산 상각비	50	51	75	102	101
무형자산 상각비	7	11	11	10	9
외환손익	39	18	7	0	0
운전자본의감소(증가)	-550	-138	-297	-219	-174
기타	143	36	85	-5	-5
투자활동으로인한현금흐름	-362	-364	-344	-249	-401
투자자산의 감소(증가)	-181	-100	-67	-1	-1
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-129	-260	-272	-240	-250
기타	-52	-4	-5	-8	-150
재무활동으로인한현금흐름	-183	-41	-92	-174	-113
차입금의 증가(감소)	-14	97	-14	-58	3
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	-88	-116	-58	-116	-116
기타	-81	-22	-20	0	0
기타현금흐름	-19	-8	63	0	0
현금의증가(감소)	-101	90	299	296	383
기초현금	661	560	649	948	1,243
기말현금	560	649	948	1,243	1,626

재무상태표

(억원)	2022	2023	2024	2025F	2026F
유동자산	3,840	3,536	3,986	4,602	5,436
현금성자산	560	649	948	1,244	1,626
단기투자자산	1,510	1,343	1,347	1,377	1,532
매출채권	524	309	538	801	921
재고자산	1,171	1,167	1,083	1,102	1,267
기타유동자산	75	68	70	78	89
비유동자산	887	1,408	1,708	1,820	1,961
유형자산	475	716	926	1,065	1,213
무형자산	105	99	101	90	81
투자자산	158	458	540	541	542
기타비유동자산	149	135	141	124	125
자산총계	4,726	4,944	5,694	6,422	7,397
유동부채	1,009	861	812	832	953
단기차입금	0	27	48	-2	-2
매입채무	251	170	187	198	227
기타유동부채	758	664	577	636	728
비유동부채	184	157	165	157	161
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	120	130	132	122	122
기타비유동부채	64	27	33	35	39
부채총계	1,193	1,018	976	989	1,114
지배주주지분	3,533	3,926	4,717	5,432	6,283
자본금	146	146	146	146	146
자본잉여금	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
자본조정 등	0	0	0	0	0
기타포괄이익누계액	19	15	89	89	89
이익잉여금	1,649	2,045	2,762	3,478	4,328
자본총계	3,533	3,926	4,717	5,432	6,283

주요투자지표

	2022	2023	2024	2025F	2026F
P/E(배)	5.8	11.6	6.0	12.9	12.0
P/B(배)	1.3	1.6	1.0	2.0	1.8
P/S(배)	1.0	1.7	1.2	2.4	2.3
EV/EBITDA(배)	2.6	7.2	2.9	7.9	7.2
배당수익률(%)	2.6	1.0	2.4	1.1	1.0
EPS(원)	2,647	1,813	2,732	2,869	3,336
BPS(원)	12,197	13,552	16,285	18,754	21,690
SPS(원)	15,751	12,147	13,742	15,216	17,496
DPS(원)	400	200	400	400	400
수익성(%)					
ROE	24.1	14.1	18.3	16.4	16.5
ROA	17.5	10.9	14.9	13.7	14.0
ROIC	58.2	25.6	35.7	33.7	33.1
안정성(%)					
유동비율	380.5	410.6	491.1	553.3	570.2
부채비율	33.8	25.9	20.7	18.2	17.7
순차입금비율	-54.3	-44.8	-43.8	-45.1	-47.5
이자보상배율	493.9	315.4	139.0	177.8	240.4
활동성(%)					
총자산회전율	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7
매출채권회전율	8.6	8.4	9.4	6.6	5.9
재고자산회전율	4.7	3.0	3.5	4.0	4.3

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
피에스케이	X	X	X

발간 History

발간일	제목
2026.01.22	피에스케이-PR Strip 중심 성장 지속
2025.04.07	피에스케이-장비 다변화의 길목

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(https://t.me/ksirsofficial)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.